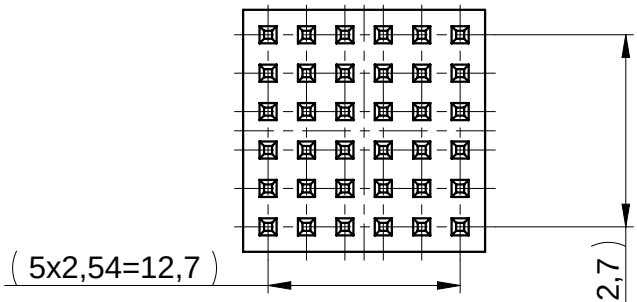
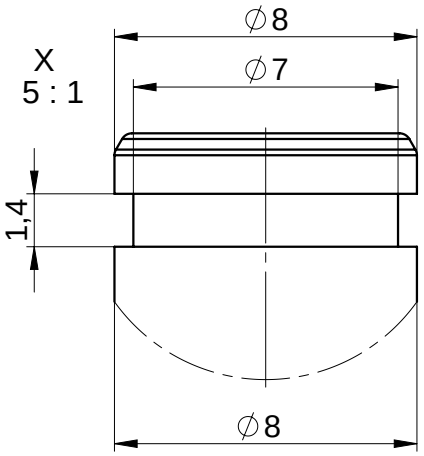
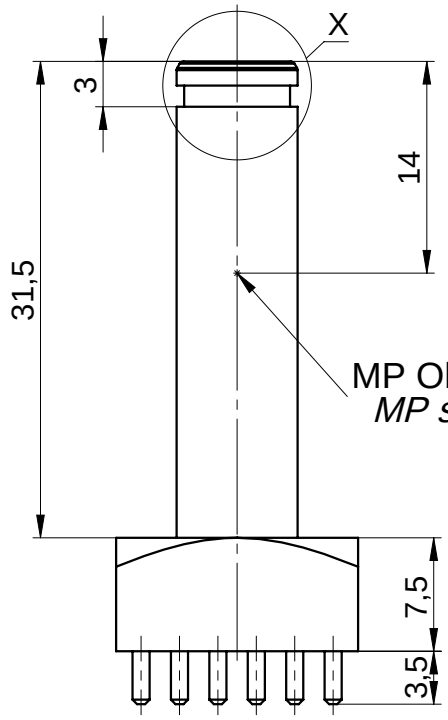
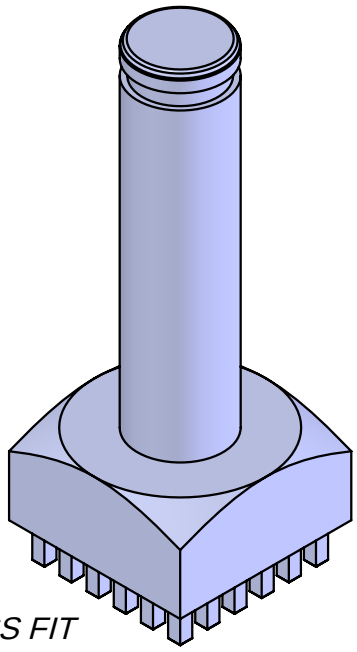
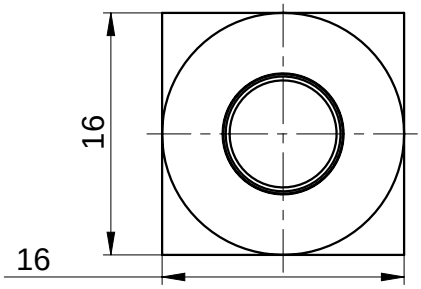






MP Oberflª chenbehandlung
MP surface treatment





Aufªhrung: EINPRESSTECHNIK
Oberflª che: gal. Cu/Ni2 Ag 4 passiviert
Mitgeltende Unterlagen fªr Bohrbild: B-RM254-ET-a
Gewicht: 30,31g
Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulª ssig!
Technische nderungen vorbehalten!

Execution: PRESS FIT
surface/coating Plating:
gal. Cu/Ni2 Ag4 passivated
PC Board Patterns see: B-RM254-ET-a
weigth: 30,31g
Surface imperfections due to electro plating processing permitted!
Technical subject to change!

W¦ RTH ELEKTRONIK
Intelligent Connecting Systems

Werkstoff / *material*: CuZn39Pb3

MaÇstab / *scale*: 2 : 1

Ursprungszg.: *drawing derivation*:

FreimaÇtoleranz: *tolerance*:

					Datum / *date*	Name / *name*
				Bearb. / *drawer*	01.07.09	W.Geck
				Gepr. / *auth.*	W.Geck 00'02+ 11:12:36 2012.05.24	
D	Zeichnung angepasst	15.05.12	Geh	geª n. / *mod.*	15.05.12	W.Geck
C	Messpunktangabe	30.08.10	Geh			
B	Neu	01.07.09	Li			
Zust. *index*	nderung *modification*	Datum *date*	Name *name*			

Benennung / *denomination*:
Powerelement Stift D8,0 vollflª chig, RM2.54, (5x), 16-er passend fªr 8mm RADSOK

Kunden-Sachnummer / *customer part number*

Zeichnungsnummer / *drawing number*:
ICS-94287

Blatt *page* 1
von *of* 1

VERTRAULICH! ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Weitergabe oder Vervielfª ltigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.
Confidential! All rigths reserve. Passing on or duplication without previous written agreement forbade.